

中微半导体设备（上海）股份有限公司

关于披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金报告书（草案）暨一般风险提示公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中微半导体设备（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式购买杭州众硅电子科技有限公司 64.69%的股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法规，本次交易不构成重大资产重组，不构成重组上市，不构成关联交易。

2025 年 12 月 31 日，公司召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》《关于<中微半导体设备（上海）股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案。具体内容详见公司于 2026 年 1 月 1 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的相关公告。

2026 年 3 月 30 日，公司召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》《关于<中微半导体设备（上海）股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的相关公告。

本次交易尚需履行多项审批程序方可实施，包括但不限于公司召开股东会审

议批准本次交易方案、上海证券交易所审核通过及中国证券监督管理委员会同意注册等。本次交易能否通过上述审批及最终取得批准或同意注册的时间均存在不确定性。公司将严格按照相关法律法规的规定披露本次交易事项的进展情况。有关信息均以公司指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

中微半导体设备（上海）股份有限公司董事会

2026年3月31日